TWSE STOCK CODE 1560

KINIK EST.1953

中砂公司法人說明會會
2025 Q3

中砂投資人服務信箱
ir@kinik.com.tw
WWW.KINIK.COM.TW

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊，係本公司基於公司資料及現況所得之資訊。
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於原物料成本增加、市場需求，各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
- 對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不保證本簡報資料之正確性，且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

報告事項

- Welcome

William Lee 李偉彰, 鑽石事業部總經理 / 發言人
Tony Pai 白景中, 副總經理 / 代理發言人

- 公司簡介
- 2025 第三季營運概況
- 近期重要事件摘要
- 2025 展望
- Q & A
- 附件: 中砂願景, 核心技術及產品, 廠區資訊

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

1560 KINIK 中砂公司簡介

- 成立於1953年; 2005股票上市, TWSE 股票代號 1560
- 實收資本額 (2025/09/30): 新台幣 14.69億
- 員工人數： 全球 ~2400人. 台灣 ~1800人. 工廠: 台灣*5, 泰國*2, 日本*1
- 2024合併營收 70.2億 TWD, EPS=7.1
- 2025H1年三大事業部與子公司主要產品及佔總營收比率.

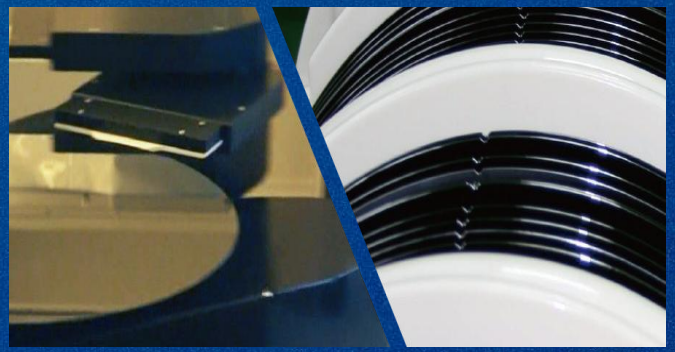
ABU 砂輪事業部(鶯歌廠)
+子公司: 鴻記/KTC/MKS/MGT
營收佔比 22%

傳統磨料及鑽石砂輪
(機械與工具機業..)

DBU 鑽石事業部
(鶯歌&樹林廠)
30%

CMP 鑽石碟
(半導體業)

SBU 晶圓事業部
(竹北&竹南廠)
48%



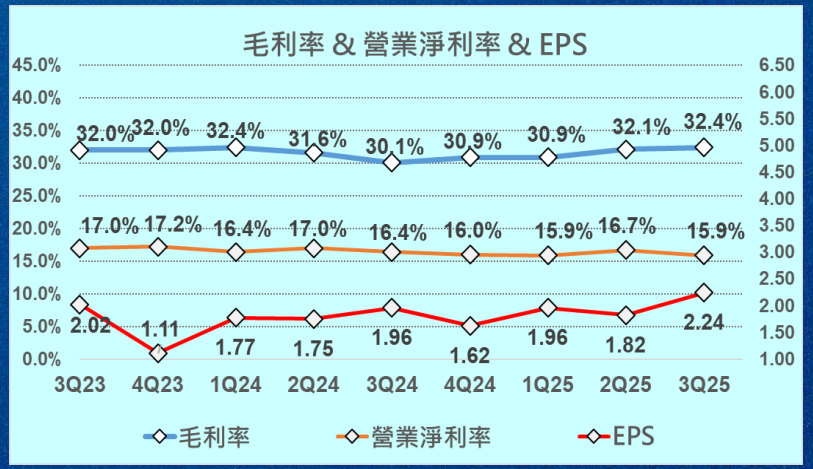
測試及再生矽晶圓
(半導體業)

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

2025 第三季營運概況 (合併財報)

- 3Q25合併營收20.9億(TWD), QoQ -1.1%, 毛利率32.4%(+0.3 ppt), EPS=2.24
- 受第三季台幣對美元平均匯率較第二季升值3.6%，毛利率受影響約-1.8%。唯相對高毛利之DBU鑽石碟出貨佔全公司營收比重增加，因此全公司毛利+0.3%。
- 業外收(支) +83.7M，其中外幣兌換與評價 +70M。

Accounting Period Income (all in thousands TWD except *)	3Q25	2Q25	QoQ	1Q~3Q25	1Q~3Q24	YoY
*Net Revenue(USD thousand)	70,219	68,421	2.6%	192,480	161,827	18.9%
Net Revenue	2,091,277	2,114,763	-1.1%	5,977,667	5,185,481	15.3%
Gross Margin	32.4%	32.1%	+0.3 ppt	31.9%	31.3%	+0.6 ppt
Operating Expenses	(344,094)	(327,610)	5.0%	(937,829)	(760,738)	23.3%
Operating Margin	15.9%	16.7%	-0.8 ppt	16.2%	16.6%	-0.4 ppt
Non-Operating Items	83,737	(15,958)	99,695	101,573	120,362	(18,789)
Net Income to Shareholders of the Parent Company	328,438	266,366	23.3%	880,619	795,708	10.7%
Net Profit Margin	15.8%	13.3%	+2.5 ppt	15.1%	15.7%	-0.6 ppt
EPS	2.24	1.82	23.1%	6.02	5.48	9.9%
ROE	17.3%	15.1%	+2.2 ppt	15.7%	15.9%	-0.2 ppt
Average Exchange Rate-USD/NTD	29.78	30.91	-3.6%	31.12	32.05	-2.9%



Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

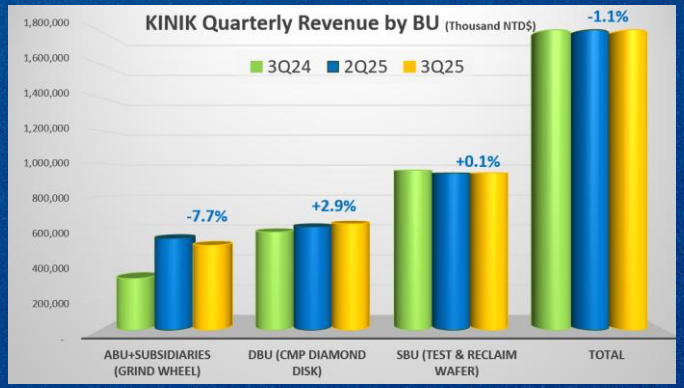
3Q25 各事業部及子公司營收

ABU: 砂輪事業部　**DBU:** 鑽石事業部　**SBU:** 晶圓事業部

砂輪子公司: 鴻記、KTC、MKS、MGT

- 全公司: 第三季營收20.9億, QoQ -1.1%. 較2024第三季增加 12.5%.
- ABU+砂輪子公司: 受機械與工具機景氣不佳影響，營收季減7.7%.
- DBU: CMP鑽石碟用於先進製程及先進封裝出貨增加， 營收季增2.9%
- SBU: 7月起單月12吋產能增加10%至33萬片，第三季高階再生晶圓出貨增加，唯特殊晶圓出貨減少，營收季增 0.1%

Business Unit	3Q24	2Q25	3Q25		QoQ	YoY
ABU+subsidiaries (Grind Wheel)	310,326	551,671	509,168	24%	-7.7%	64.1%
DBU (CMP Diamond Disk)	589,715	620,784	638,589	31%	2.9%	8.3%
SBU (Test & Reclaim Wafer)	959,557	942,307	943,521	45%	0.1%	-1.7%
Total	1,859,597	2,114,763	2,091,277	100%	-1.1%	12.5%



Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

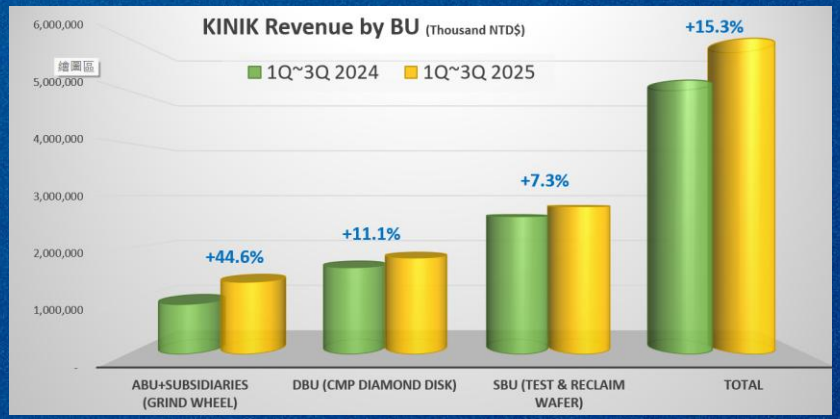
1Q~3Q25 各事業部及子公司營收

ABU: 砂輪事業部　**DBU:** 鑽石事業部　**SBU:** 晶圓事業部

砂輪子公司: 鴻記、KTC、MKS、MGT (MKS/MGT 2025年4月起併入)

- 全公司: 2025前三季營收 YoY +15.3%.

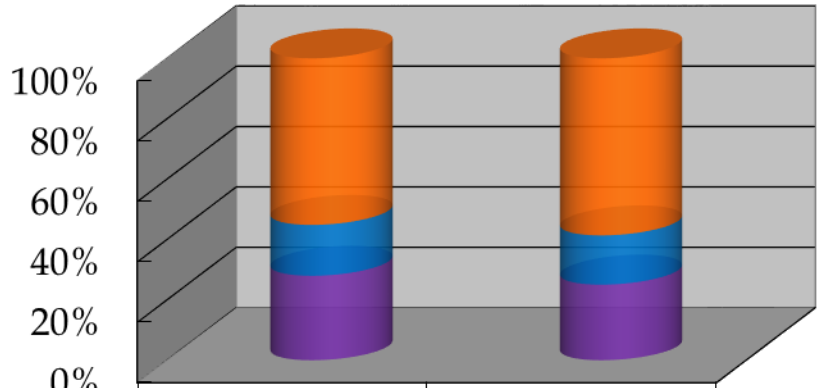
Business Unit	1Q~3Q 2024	1Q~3Q 2025		YoY
ABU+subsidiaries (Grind Wheel)	941,712	1,362,162	23%	44.6%
DBU (CMP Diamond Disk)	1,638,601	1,820,791	30%	11.1%
SBU (Test & Reclaim Wafer)	2,605,169	2,794,715	47%	7.3%
Total	5,185,481	5,977,667	100%	15.3%



Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

3Q25 鑽石碟營收表現(1/2)

國內外客戶鑽石碟營收百分比

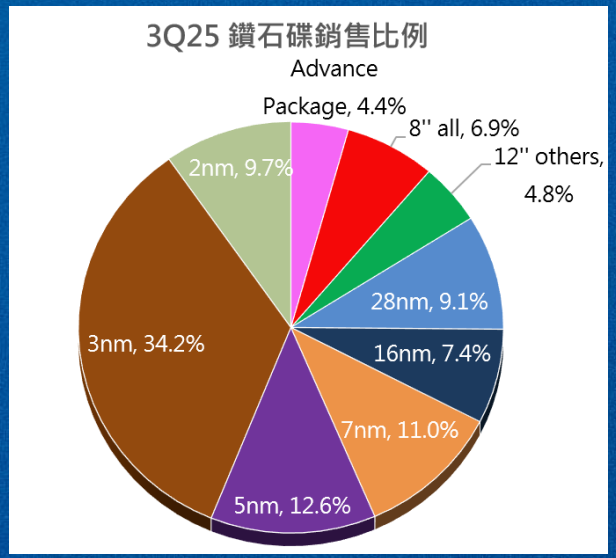


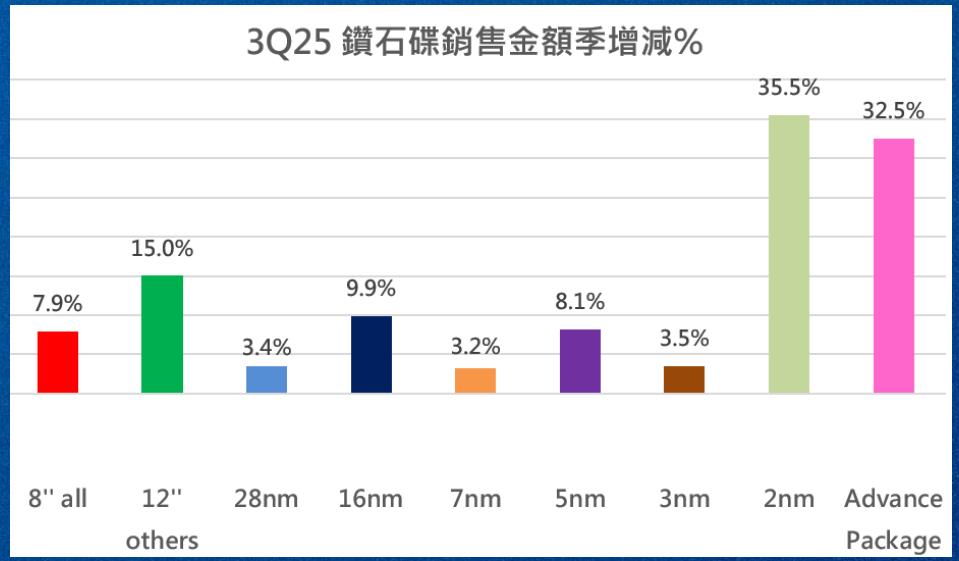
	2025 Q2	2025 Q3
台灣最大單一客戶	55.18%	58.65%
台灣其他客戶	16.85%	16.32%
外國客戶	27.97%	25.03%

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

3Q25 鑽石碟營收表現(2/2)

- 3Q25 DBU 營收6.2億, QoQ +10.6%。
- 單一最大客戶先進製程產品(5奈米以下及先進封裝)營收比重從60.0%增加至60.8%，2nm的鑽石碟營收增加35.5%。



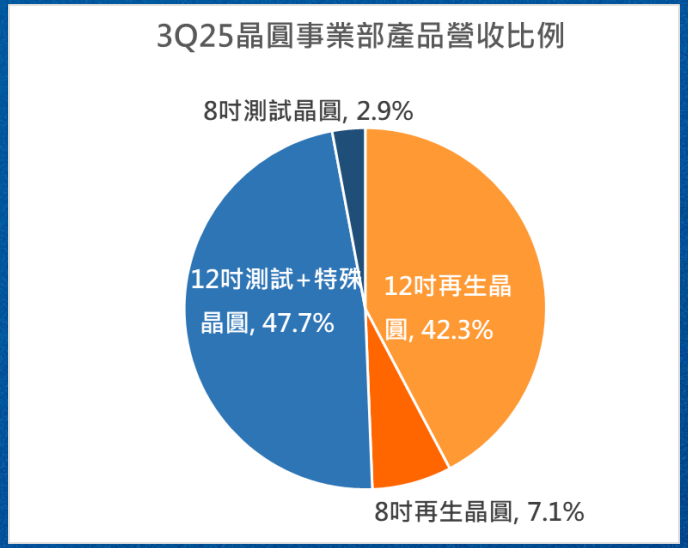


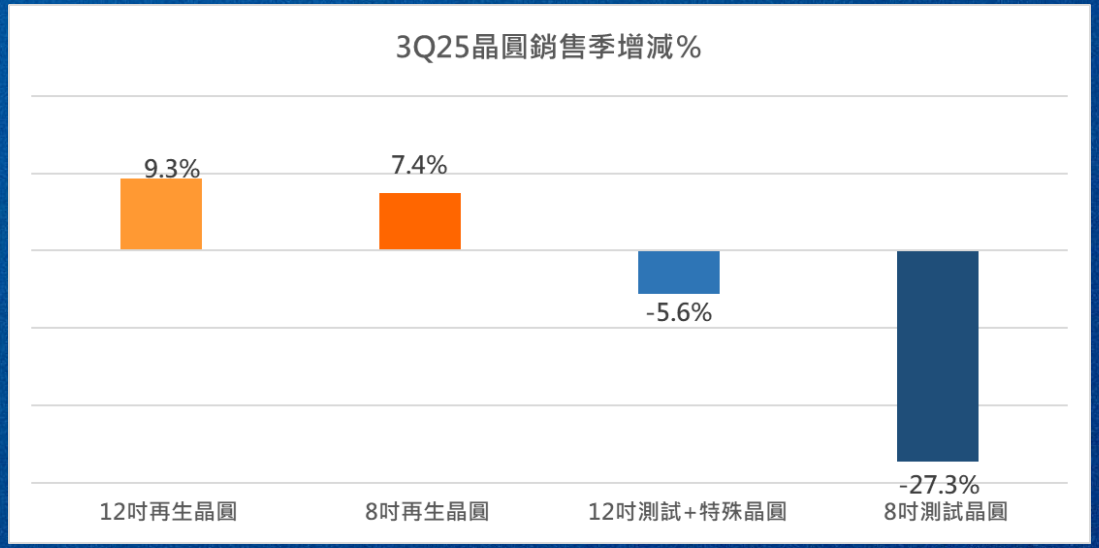
備註：資料對象為單一最大客戶.

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

3Q25 晶圓事業部產品別分析

- SBU第三季營收9.43億元，季增 0.1%。
- 高階再生晶圓營收增加，測試與特殊晶圓營收較第二季減少。





Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

近期重要事件摘要

- 依本公司109及111年度員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理，，於114年7月1日起至9月30日止已執行407,500股，以上員工認股權執行共共募得資金59,389,600元，增資後實收資本額為新台幣1,469,410,800元。訂定114年第三季發行新股增資基準日為114年10月28日。

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

展望 2025

- **ABU 砂輪事業部與砂輪子公司:**
  - 2025下半年台灣傳產機械工具機客戶受匯率及關稅影響，產能利用率下降。
  - 四月起新併購之日本MKS與泰國MGT砂輪子公司，下半年預估營收持平。
- **DBU 鑽石事業部**
  - 第四季先進製程及2奈米用之鑽石碟需求將持續增加。
  - 新增之國外IDM客戶，第三季起已成功導入其最先進製程開始貢獻營收，第四季起也陸續送樣其成熟製程，並預期逐季增量。
  - 年底前出貨預期接近五萬顆/月，2026年將依據需求持續新增產能。
- **SBU 晶圓事業部：**
  - 目前12吋產能33萬片/月持續滿載，2026第三季起將再增加7萬片，屆時總產能40萬片，以滿足先進製程之客戶需求。
  - 第四季之高階產品組合比重將持續提高，有助以減小匯率之影響及提高毛利率。

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

Q & A

報告完畢
敬請指教

中砂投資人服務信箱
ir@kinik.com.tw

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

附件

- ◆中砂經營理念
- ◆中砂產品介紹
- ◆各廠區資訊
- ◆榮耀記事

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

企業經營理念使命與願景

經營理念

Business philosophy
Good together
Good to You, Me, All

共好

你好，我好，大家好

使命

Mission

Keep creating innovative values for industries and customers.

精益求精為產業
與客户創新價值

願景

成為研磨解決方案的
卓越智造與服務中心

Vision

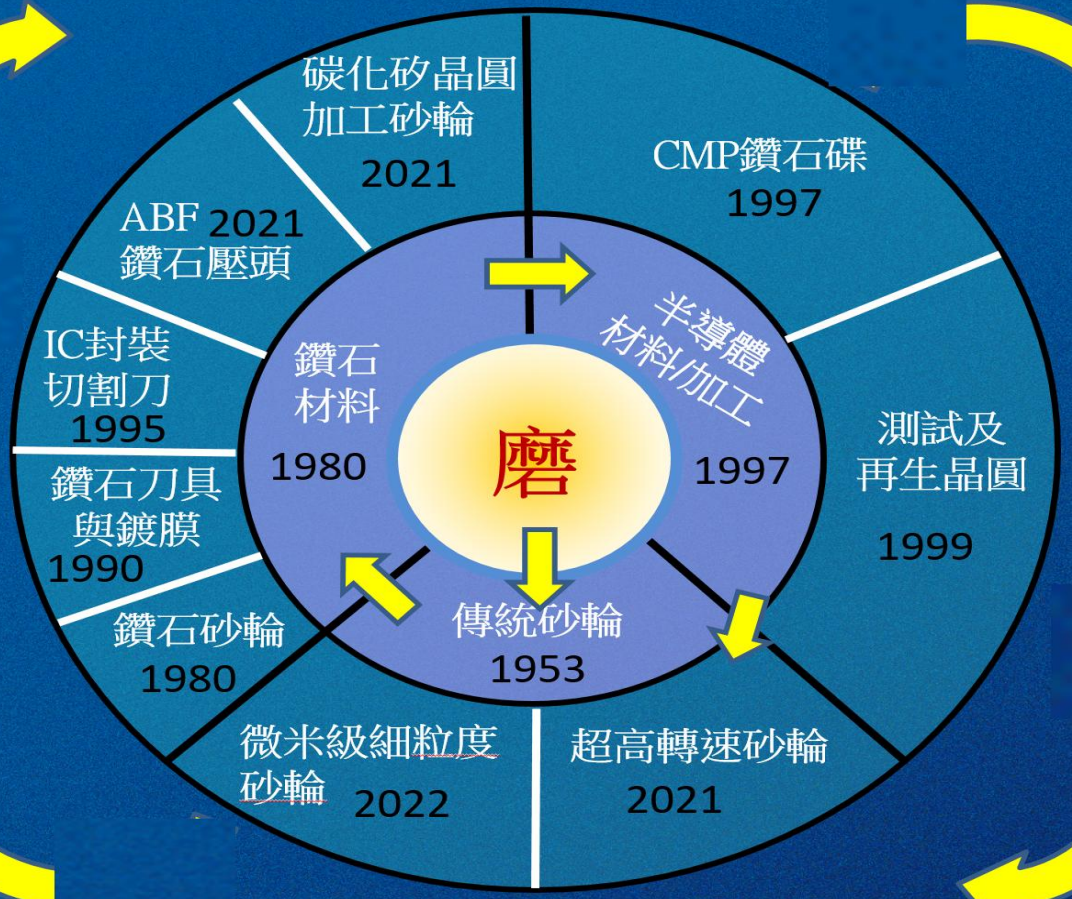
Become an excellent and intelligent smart manufacturing and service center for grinding solutions.

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

從磨石頭到磨半導體
中砂的70年成長之路與未來展望

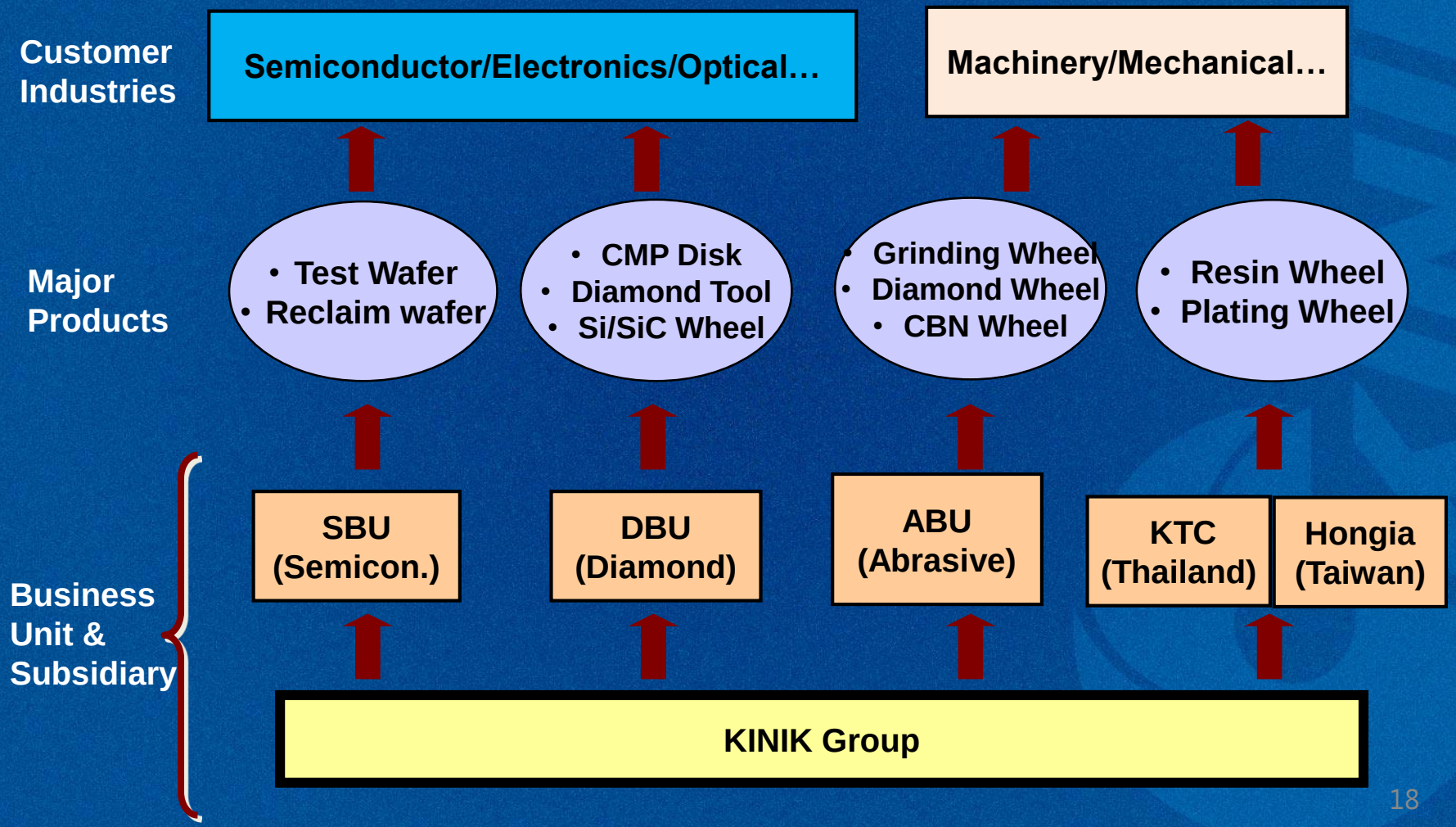
Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

以「磨」為核心提供各產業所需產品



循著砂輪的旋轉軌跡不斷前進

Major Product and Business Diagram



KINIK COMPANY

中砂公司 TWSE STOCK CODE 1560

EST.1953

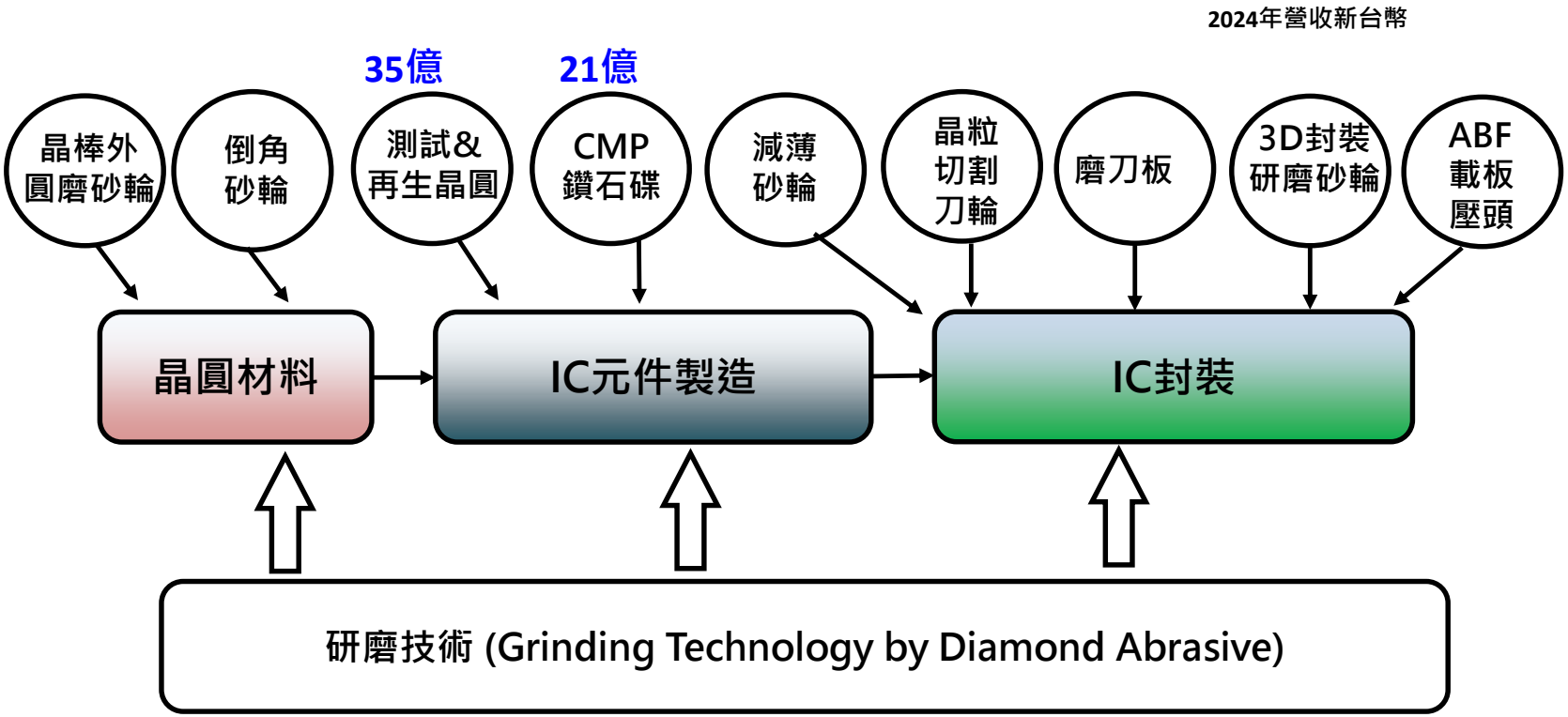
KINIK

中砂產品介紹

Products Introduction

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

中砂研磨產品在半導體製程的角色



2024年中砂在半導體相關產業的營收58億元，佔KINIK合併營收約82%，
且毛利率34%(3%高於2024全部產品的平均31%)

測試&再生晶圓 Test/Reclaim Wafer

What is test and reclaim wafer?

The source of the reclaimed wafers comes from the monitor wafers and the dummy wafers but not the defect wafers manufactured by the semiconductor fab. The services we provide to refurbish these reclaimed wafers can dramatically lower the running cost of a semiconductor manufacturer.

The reclaimed wafers can be categorized according to functions as figure 1 and the reclamation system is shown as figure 2.

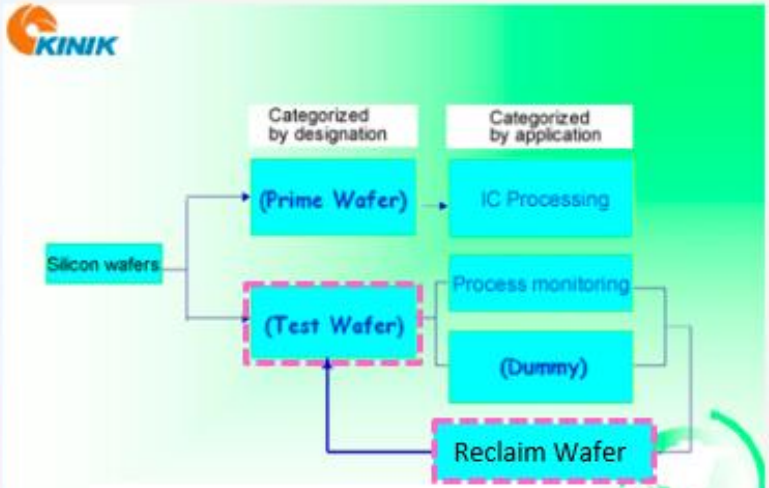


Figure 1 - The classification of the wafer application

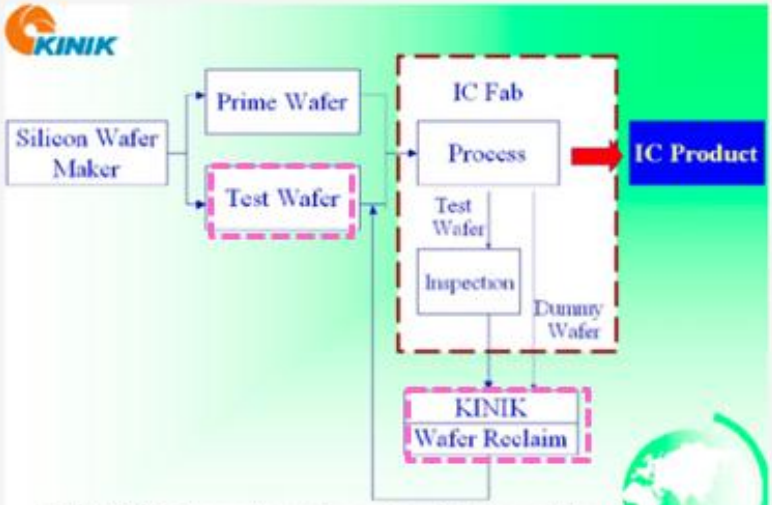


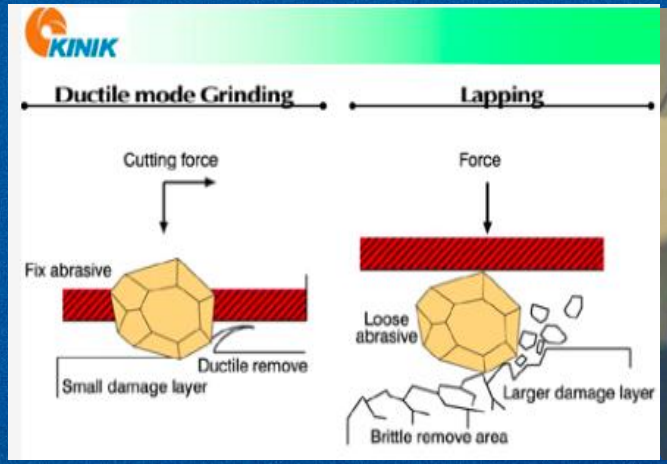
Figure 2 -The reclamation system for the reclaimed wafer

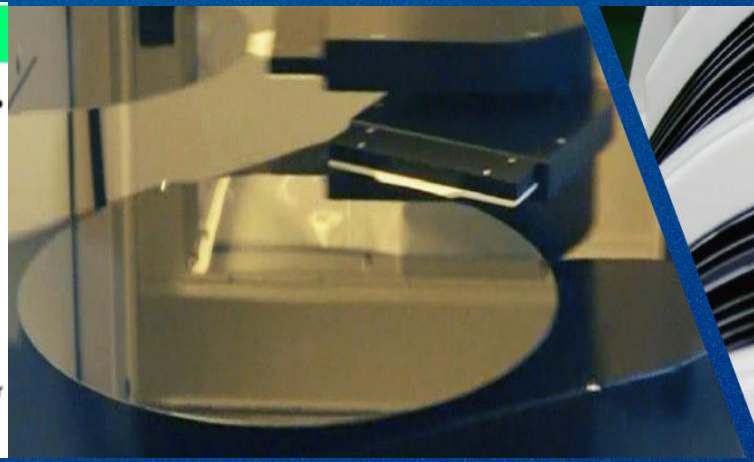
Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

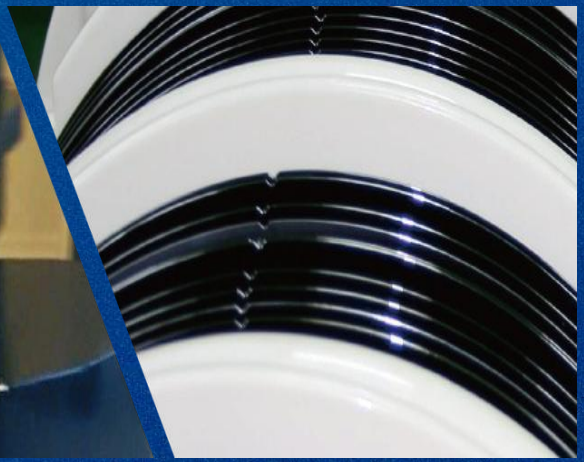
測試/再生晶圓 Test/Reclaim Wafer

中砂的測試與再生晶圓之製程特色以延性輪磨(Ductile Mode Grinding)加工取代傳統研磨(Lapping)加工，目的是降低加工之變質層，減少化學藥品污染，且可提高加工精度，為最先進之再生晶圓製程。

The features of the KINIK's test and reclaimed wafers are processed by ductile mode grinding used to replace traditional lapping to lower the damaged thickness on the surface and for less chemical contamination. The ductile mode grinding is the leading-edge process for the high precious reclaimed wafers.





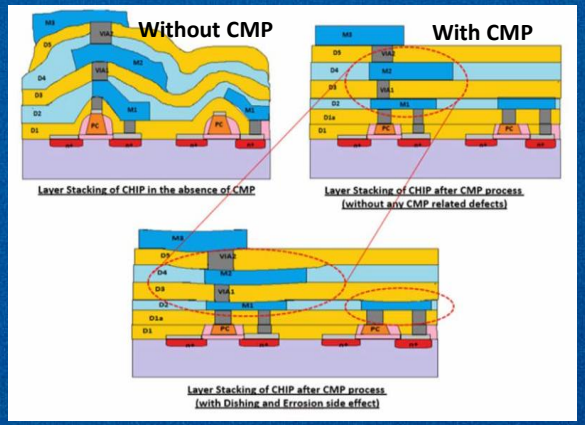


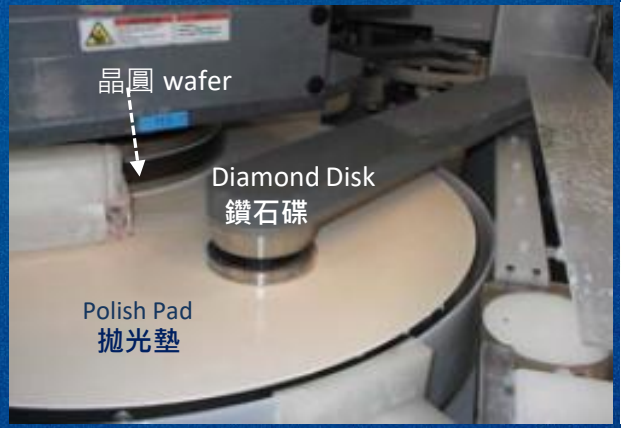
Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

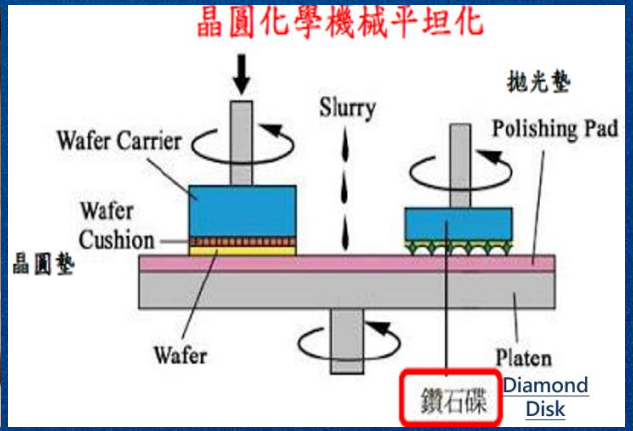
CMP鑽石碟 Diamond Disk

CMP (Chemical Mechanical Polish) 化學機械拋光，主要用於先進IC製程中，透過拋光墊與拋光液同時透過機械與化學反應加工晶圓表面，達到表面晶圓材料的移除及整體的平坦化，才能接續後續製程以及提高良率，進而能循摩爾定律持續微縮IC線寬面積，推展出N5/N3/N2先進製程。而**鑽石碟**的功用就是在拋光晶圓的同時去加工拋光墊，以移除拋光時的副產物及穩定拋光速率並提升良率及延長拋光墊使用壽命，是先進IC拋光製程中提升良率及控制成本中非常重要的一環。

CMP (Chemical Mechanical Polish) is widely used for advanced IC manufacturing processes for surface material removal, smoothing surfaces, and planarization by the polish pad (mechanical) and the abrasive slurry (chemical reaction). And the **diamond disk (aka pad conditioner)**'s function is to in-situ dress the polish pad during the process to remove the polish byproduct, to maintain a stable pad roughness and remove rate, to improve yield, and to prolong the lifetime of the pad.







Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

CMP鑽石碟 Diamond Disk

中砂鑽石碟用於半導體化學機械研磨製程中修整研磨墊以達到理想移除率及平坦度。

KINIK diamond disk is used on semi-conductor CMP process in order to make the pad reach the desirable removal rate and uniformity.

Conventional Disk

DiaGrid®

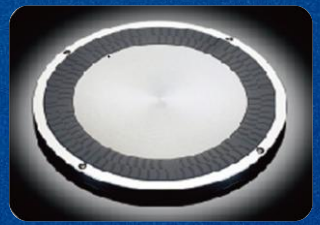
I-DiaGrid®

S-DiaGrid®

Advanced Disk：High Performance / Long Life Time

Pyradia®

EDP Disk
(Metal Free)



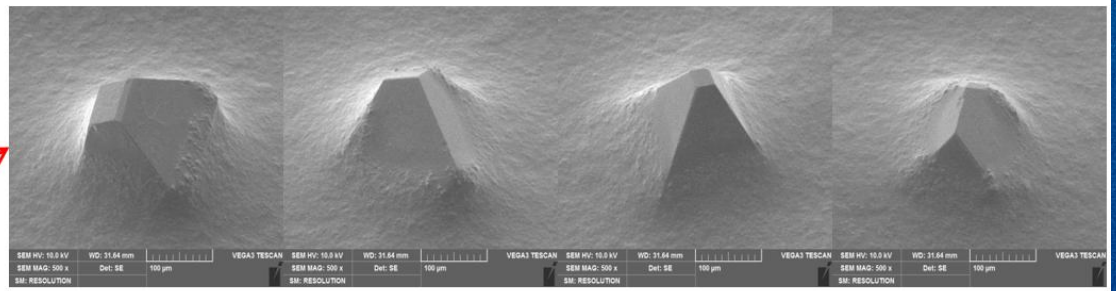
CVD -WAVE®

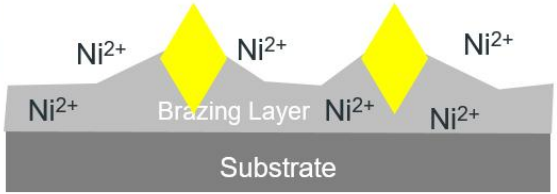
equaDia®

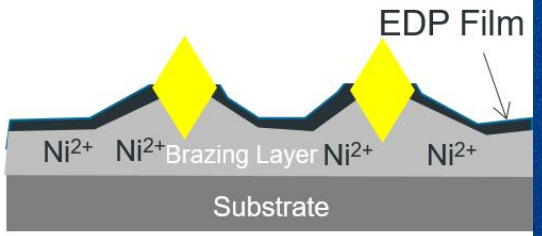
Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

EDP Disk for Metal Free Solution

- Diamond disk protected with EDP film for metal-free requested in advanced IC technologies.





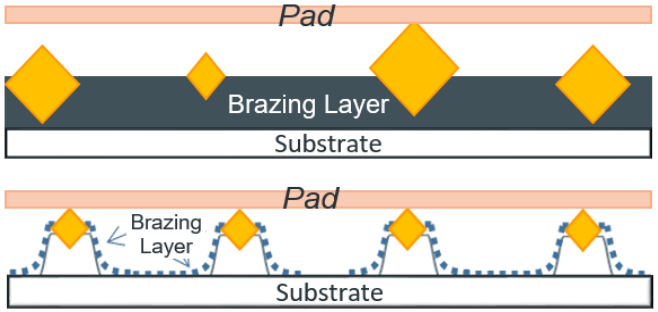


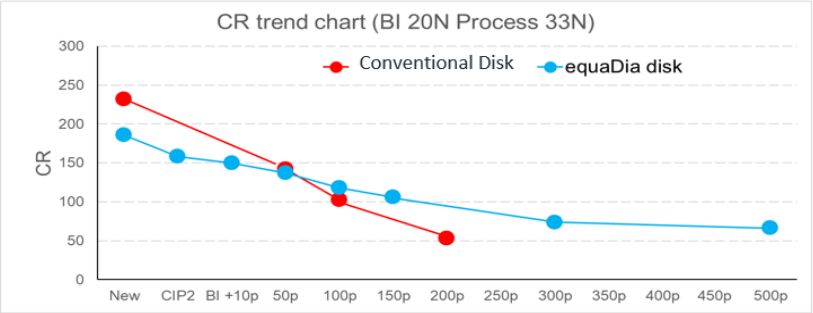
- EDP Film is Epoxy. It is acid and alkali resistant, and effectively prevent from precipitation of metal ions during the manufacturing process.
- Both sides of a disk can be coated for better protection.

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

equaDia Disk® 鑽石碟

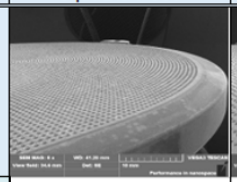
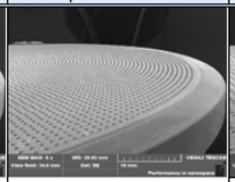
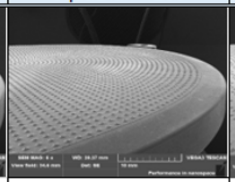
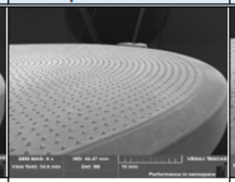
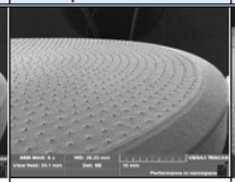
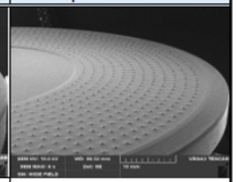
- Advanced disk “equaDia” for excellence tip height leveling and longer lifetime.





➢ Conventional Disk dressed a pad with the high points of the diamond. equaDia disk has good diamond leveling, and each diamond works. CR decay of equaDia disk is much slower.

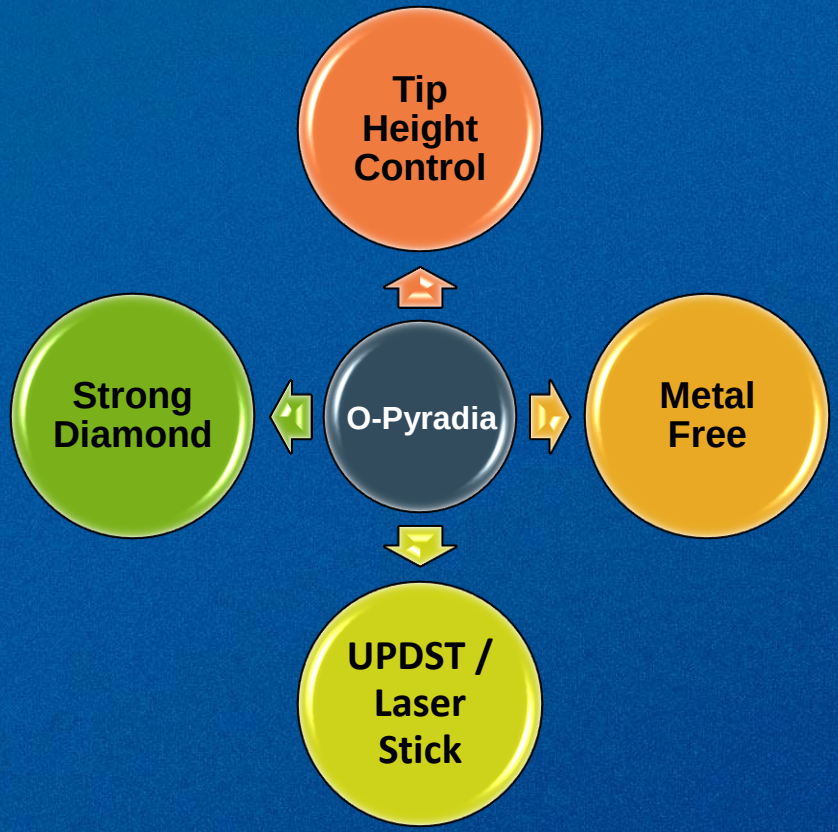
CR decay rate	100p	200p	300p	500p
Conventional Disk	56%	77%	-	-
equaDia disk	25%	-	54%	58%

	equaDia P800	equaDia P1000	equaDia P1200	equaDia P1500	equaDia P2000	equaDia P2000
SEM						
Appearance	Full face	Full face	Full face	Full face	Full face	Donut type
Diamond Size (μm)	100	100	100	100	170	170
Diamond pitch (μm)	800	1000	1200	1500	2000	2000
Diamond Bonded (%)	55%	53%	56%	51%	53%	55%
Leveling (μm)	6.9	7.2	7.6	6.7	9.7	9.9
total diamond count (ea)	11600	7450	5200	3350	1900	1400

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

Metal-free O-Pyradia® 鑽石碟

- O-Pyradia CMP pad conditioner for advanced customer's tightened metal contamination control.



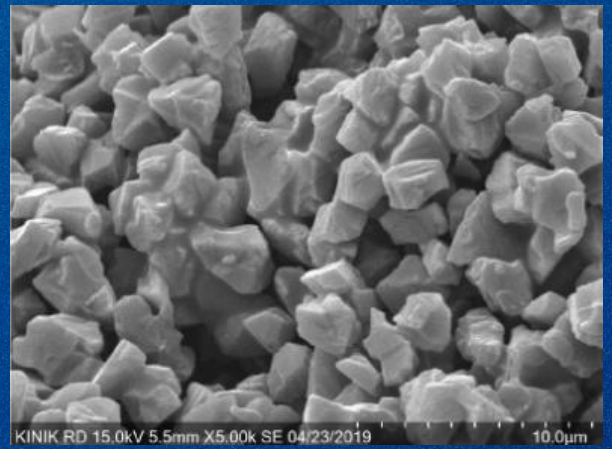
Pyradia Type	O-Pyradia	Pyradia
Photo		
Material of Substrate	Polymer	Metal
Bonding Material	Polymer	LM(Ni ; Cr powder)
Bonding Strength	+	++
Process Temp	<100 degree	~1000 degree
Diamond Strength	++	+
Acid and alkali resistant	Metal Free	Ni ; Cr

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

Wafer Grinding Wheel

- 中砂的晶圓研磨砂輪可用於矽晶圓加工、IC封裝(WLP/PLP/2.5D/3D)、碳化矽、藍寶石及再生晶圓等硬脆材料的直立式進給研磨加工應用。直立式進給的晶圓研磨加工一般包括粗及細研磨製程，可依客戶加工需求，來客製化設計陶瓷結合劑，鑽石磨料及微結構組織。晶圓研磨砂輪的鑽石粒度一般為#325～#1000及#2000～#8000。其特色為有穩定的高材料移除率、長效使用壽命及低研磨阻抗電流等優點。

晶圓研磨砂輪



孔隙微結構組織

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

鑽石滾輪

- 鑽石滾輪乃應用於複雜形狀且高精度之成形研磨砂輪的修整(例如氧化鋁, 碳化矽, 氮化硼cBN砂輪)，適用於例如滾珠螺桿、滑軌、軸承、齒輪、刀治具、汽車及航太零件等產業之精密元件，於成形或創成批量產研磨加工時維持砂輪形狀精度的自動化修整作業。
- 鑽石滾輪是利用天然/人造或CVD鑽石，以反轉電鑄或滲透燒結等製法來製作而成，鑽石採隨機或規則性的排列，具有高形狀精度及高修整效率等特色，我們可依客戶需求提供適用於各式不同磨床機台與成形研磨加工應用的各製法鑽石修整滾輪。

滾珠螺桿成形砂輪修整用鑽石滾輪

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

半導體及光電業工具

Semiconductor & photoelectric Tool

中砂以最新電鑄、成型與燒結技術製造成的精密鑽石切割刀。搭配特殊的金屬與樹脂等結合劑，使切割軟刀具備高剛性、低磨耗且具備良好的自銳性；適合在各類精密陶瓷、硬脆材料、磁性材料，光學玻璃，印刷電路板與半導體封裝材料的切割應用。

KINIK Company announces the introduction of Super Hubless Dicing Blade with resin, metal and nickel matrices. The dicing blades are manufactured by specialty consolidation, sintering and electro-forming process that improve the uniformity of the thin blades. They are suitable for cutting ceramics, brittle materials , optical glass, printed circuit boards, especially for semiconductor packaging.

鑽石切割軟刀 Dicing Blade

磨刀板 Dressing Board

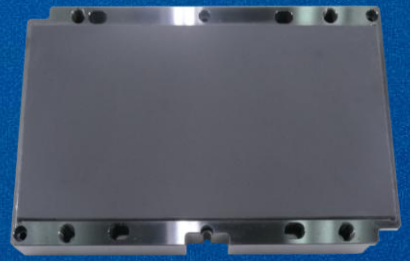
Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

半導體及光電業工具

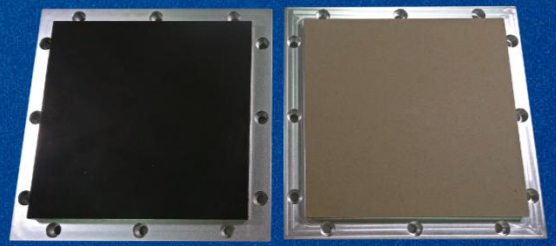
Semiconductor & photoelectric Tool

多孔質陶瓷真空吸盤

Porous Ceramic Chuck Table



多孔質陶瓷孔洞均勻微細、不發塵、可具靜電消散特性，應用於真空吸盤具備吸力均勻、局部吸附性、不產生印痕、工作效率及精度高等優點，可充分應用於半導體研磨、清洗、切割及檢測等設備。



- High-performance, High-precision, Uniform suction force.
- Partial chucking without sagging.
- Chucking and transport of wafer without leaving suction marks.
- Produces no static electricity and dust.

Application：
Wafer grinder, cleaning/dicing machine and measuring equipment, etc.

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

精密加工PCD刀具

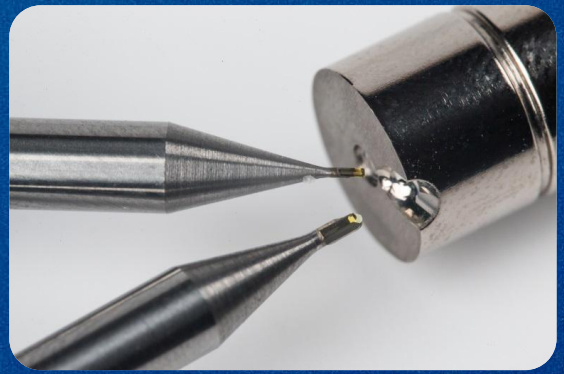
Ultra Precision Machining Tools

中砂提供電子業、PCB板、木工業及金屬加工業所需的單晶（SCD）、聚晶鑽（PCD）、立方氮化硼（PcBN）等鑽石刀具已逾20年。

近年積極投入生產高精度、更微小之SCD、PCD 及 PcBN產品供光學業、精密模具等加工技術使用，如：單晶鑽石車刀與銑刀、PcBN微小徑銑刀等。

KINIK company already has more than 20-year experience in providing all kinds of diamond tools for the applications of PCB, woodworking and metal working industries.

Recently, KINIK also developed several kinds of SCD, PCD and PcBN precision micro tools to meet high-end market's requirements.



加工面達到極高的光潔度表現。
High finish at processing parts.

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel

中砂提供各式平面、內外圓、無心及雙平面等工件研磨及切斷用的傳統、BD及電鑄砂輪。

主要產業應用包含精密機械業的滑軌及齒輪研磨與砂輪成形修整用的鑽石滾輪、鋼鐵業的輥筒研磨、工具製造業的高速鋼鑽頭、CNC及PCD/PcBN刀具等研磨、半導體業的晶圓減薄及倒角研磨、高效率硬脆材料如SiC研磨用的蜂巢砂輪、光學模具模仁拋光等。

KINIK provides various grinding wheels for surface, internal & cylindrical, centerless and disc surface grinding and cutting of workpiece production. The main industrial applications include linear guideway, gear grinding and diamond roller for dressing wheel in precision machinery, steel roll grinding, HSS drill, CNC & PCD/PcBN tool grinding, wafer thinning and edge grinding in semiconductor, honeycomb wheel for high-efficient grinding of hard and brittle materials such as SiC, optical mold polishing etc.

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel

平面研磨
Surface Grinding

外圓研磨
Cylindrical Grinding

輥筒研磨
Roll Grinding

滑軌成形研磨
Linear Guideway Grinding

雙平面研磨
Disc Surface Grinding

齒輪研磨
Gear Grinding

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel

光學模仁拋光
Optical Mold Polishing

內圓研磨
Internal Grinding

CNC刀具研磨
CNC Tools Grinding

蜂巢砂輪
Diamond & CBN Honey Comb Wheel

PCD刀具研磨
PCD Cutting Tools Grinding

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel

電鑄砂輪
Electroplated Diamond & CBN Wheels and Products

各式切斷及可彎曲、碟式砂輪
Cut-off, Depressed & Flexible Wheels, and Flap Disc

鑽石滾輪
Diamond Roller

砂輪動平衡校正儀
Grinder Balancer

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

廠區 Plant

總 公 司 Head Office
鶯歌廠區 Yingge Factory

239010 新北市鶯歌區中山路64號
No.64, Zhongshan Rd., Yingge Dist.,
New Taipei City 239010, Taiwan
TEL:+886 2 2679-1931~40

Grinding Wheel & Diamond Disk

樹林廠區 Shulin Factory

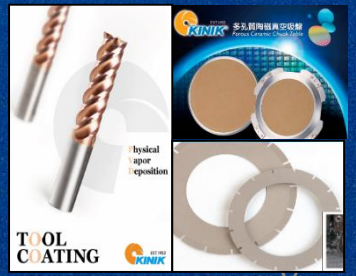
238010 新北市樹林區中山路2段151巷16號
No.16, Ln. 151, Sec. 2, Zhongshan Rd.,
Shulin Dist., New Taipei City 238010, Taiwan
TEL:+886 2 8684-4111~13

Diamond Disk
Diamond Cutting & Dicing Tools

新竹廠區 Hsinchu Factory

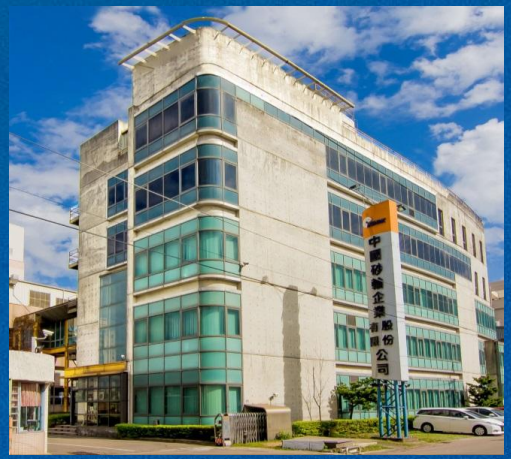
303035 新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路6號
No.6, Wenhua Rd., Hukou, Hsinchu Ind.
Park, Hsinchu County 303035, Taiwan
TEL:+886 3 598-4990

Diamond Dicing Tools. PVD Coating
Ceramic Vacuum Chuck



Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

廠區 Plant

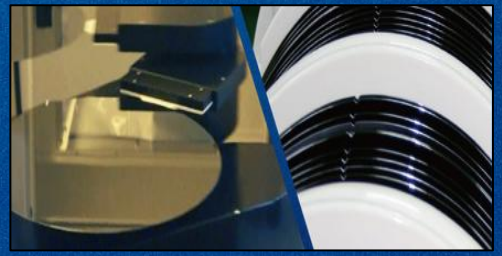


竹北廠區 Zhubei Factory

302059 新竹縣竹北市十興路260號
No.260, Shixing Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302059, Taiwan
TEL:+886 3 550-7160~5

竹科廠區 Hsinchu Science Park Factory

350401 苗栗縣竹南鎮科北五路6號
No. 6, Kebei 5th Rd., Jhunan Township, Miaoli County 350401, Taiwan
TEL:+886 3 550-7160



Reclaim & Test Wafer
再生晶圓 & 測試晶圓

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

廠區 Plant

SINCE 1978 HONGIA® 鴻記工業股份有限公司
HONGIA INDUSTRY CO., LTD.

鴻記工業股份有限公司
Hongia Industry Co, Ltd.
239008 新北市鶯歌區余厝巷2號
No. 2, Yucho Lane, Yingge Dist.,
New Taipei City 239008, Taiwan
TEL:+886 2 2679-1006
Email : hongia-sale@kinik.com.tw
www.hongia.com.tw

Electroplated Diamond Wheel 電鑄砂輪

金力泰國有限公司
Kinik - Thai Co., Ltd.
225 Moo 7 , Khok Pip, Simahosot,
Prachinburi 25190 Thailand
TEL:+663 727 6954
Email : sales@kinikthai.co.th
www.kinikthai.co.th

Resin and Ceramic Wheel
樹脂砂輪&陶瓷砂輪

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

Acquired MKS (Japan) & MGT (Thailand) as subsidiaries on April 2025

中砂KINIK 集團創業72周年慶
歡喜迎接新紀元

中砂 KINIK

日本MKS 及 泰國MGT 公司正式加入，開創全球發展新篇章

中砂報

活動日期：2025/04/01
出刊日期：2025/04/01

2025年4月1日，是中砂KINIK集團歡慶創業72周年的日子，同時也是集團迎來重要的里程碑—原在日本三井金屬鑛業集團旗下的日本MKS 公司和泰國的 MGT 公司 正式加入KINIK集團邁向全球化發展的新階段。
今天舉辦的正式收購交割及更名揭牌儀式標誌著 KINIK 集團在精密研磨與半導體材料研磨領域的全球擴張，並開啟了集團進一步提升技術創新和市場競爭力的嶄新篇章。

MKS、MGT 新名創新局

自2025年4月1日起，MKS 公司正式更名為 マックスキニック精密株式会社 (英文名稱:Max Kinik Seimitsu Co., Ltd.), MGT公司更名為 Max Kinik Grinding Technology Co., Ltd.。
此次更名由 KINIK 集團股東提出，新名稱中的 "Max" 代表規模最大化，"Kinik" 承載著 KINIK 集團在研磨領域的專業精神，象徵著公司將專注於最大化其潛力及市場影響力。而 "Seimitsu"及 "Grinding Technology" 則代表對精密加工技術的極致追求。MKS暨MGT社長坂井正博表示：「今天是我們公司歷史中的一個重要時刻，作為 KINIK 集團的一員，我們將繼承百年來積累的技術實力與市場聲譽，並結合 KINIK 集團的全球資源，共同創造更多的發展機會。」

強化全球市場競爭力

此次MKS 和 MGT加入KINIK集團， 不僅是KINIK集團對這兩家公司的肯定，更是集團邁向全球市場的重要步伐。
KINIK集團林伯全董事長表示：「今天，MKS和MGT正式成為 KINIK 集團的一員，這不僅是KINIK集團對兩家公司過去努力的肯定，更是大家一起面對未來挑戰的新起點。我們將繼續傳承三井研削的卓越技術，並結合 KINIK 集團的資源，推動全球市場的拓展，不斷創新、挑戰行業的更高標準。」

跨越百年，凝聚力量創新發展，攜手磨出共好大未來

KINIK 集團謝榮哲執行長在致詞中指出：「砂輪產品雖然看似不起眼，但其在汽車、航空、機械加工及半導體等關鍵領域扮演著至關重要的角色。隨著 MKS和MGT的加入，KINIK集團在台灣、泰國、日本設有生產基地、在該三國及中國大陸設有營業單位，產品行銷全球五十多個國家，集團內公司將發揮彼此的技術優勢，提升品牌影響力，開創新的成長契機。」
謝執行長表示：「新公司名稱的揭牌象徵著新時代的開始。我們希望在擁有百年歷史的『MKS』優秀傳統基礎上，與各位共同發揮相互的優勢，建立互信關係，攜手邁向更美好的未來。今後，我們一起努力磨出共好大未來。」

共好：你好、我好、大家好！讓我們攜手磨出共好大未來！

All Rights Reserved.

榮耀記事 Milestone

2021年11月榮獲行政院「第26屆國家品質獎 全面卓越類 - 績優經營獎」。

Nov. 2021, Honored with "BUSINESS MERIT AWARD of Total BUSINESS EXCELLENCE" at the 26th NATIONAL QUALITY AWARD from the Executive Yuan, R.O.C.

https://nqa.cpc.tw/NQA/Web/Awards26th_Content.aspx?p=f2b6e812-92aa-49c3-8149-1e005a0fe706

賀!中國砂輪公司榮獲「第26屆國家品質獎」

經濟部 林全能次長(左)、中國砂輪公司 林伯全董事長(右) 。圖/經濟部工業局提供。

中國砂輪公司 榮獲「第26屆國家品質獎」，林伯全董事長受邀晉見總統

中國砂輪公司董事長 林伯全(右)、總統 蔡英文(左)。圖 / 總統府提供

榮耀記事 Milestone

台 灣 精 品 獎
Taiwan Excellence Award 2022
特頒予
Presented to
中國砂輪企業股份有限公司
KINIK COMPANY
12吋再生晶圓
12" Reclaimed Wafers
19nm/26nm
王美花
經濟部 部長
Minister, Ministry of Economic Affairs, R.O.C.
中華民國110年11月24日
24th of November 2021

2021年10月榮獲經濟部「2022年第30屆台灣精品獎 - 12吋再生晶圓」。

Oct. 2021, Honored with "Taiwan Excellence Award - 12" Reclaimed Wafers" from the MOEA, R.O.C.

https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/product/1110433

台灣精品
2022

TAIWAN EXCELLENCE

得獎產品：12 inches Reclaim Wafer

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

榮耀記事 Milestone

榮獲經濟部第四屆卓越中堅企業獎
Honored with 4th Taiwan mittelstand Award from the MOEA, R.O.C, in 2017.

榮獲經濟部2013年 第14屆
工業精銳獎 機械、運輸工業類
Honored with 14th Industrial Sustainable Excellence Award from the MOEA, R.O.C, in 2013.

TOP 100
TAIWAN BRANDS

榮獲經濟部台灣百大品牌獎
Honored with the Top 100 Taiwan Brands Award from the MOEA, R.O.C, in 2011.

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.

榮耀記事 Milestone

榮獲經濟部2006年台灣優良品牌獎
Honored with the Taiwan Superior Brand Award from the MOEA, R.O.C, in 2006.

榮獲第十屆經濟部產業科技發展傑出獎
Award of Excellence, the 10th R.O.C. MOEA Industrial Technology Advancement Award in 2002.

全國第一家砂輪公司榮獲國家傑出精品獎
The first grinding wheel plant won Excellent Product Award in 1993.

Copyright© KINIK COMPANY, All Rights Reserved.